

※プログラム※

講演セッション

3月11日(水)

【A会場】

「高速伝送を支える最新技術」

10:45~11:00

11A-01 遺伝的アルゴリズムによる高インピーダンス線路装荷形イコライザの設計

○鈴木雄将, 山岸圭太郎, 斉藤成一, 大橋英征(三菱電機)

11:00~11:15

11A-02 新電磁界解析ツールMomCACEを用いたデバイスの解析/設計手法

○山岡正拓, 瓜生一英, 山田 徹(パナソニック(株))

11:15~11:30

11A-03 FPCで接続された基板の電磁特性

○太田雅之, 作左部剛視, 高橋丈博, 澁谷 昇(拓殖大学大学院電子情報工学専攻)

11:30~11:45

11A-04 緩和法を用いたADI-FDTD法とその並列処理

○小国直樹, 浅井秀樹(静岡大学)

11:45~12:00

11A-05 並列分散型LIMに基づく高速回路シミュレーション

○井上雄太(静岡大学創造科学技術大学院), 関根惟敏(静岡大学大学院工学研究科), 浅井秀樹(静岡大学工学部)

12:00~13:00 休憩

13:00~13:30 ☆招待講演

11A-06 オンチップノイズモニタ技術とLSIの電源インテグリティ評価

○永田 真(神戸大)

13:30~13:45

11A-07 電源-グラウンド間インピーダンス付加による非理想電源下でのIBISモデルの精度向上

○岡 典正, 五百旗頭健吾, 豊田啓孝, 古賀隆治(岡山大)

13:45~14:00

11A-08 部品内蔵基板におけるEMI低減 コンデンサ配置方法の検討

○三浦雅広, 島田 諭, 宮崎 誠, 初澤健次, 花岡仁登, 松田 徹(長野沖電気株式会社)

14:00~14:15

11A-09 UV改質処理を用いたシクロオレフィンポリマーフィルム上へのメタライジング

○西村宜幸, 飯森陽介(関東学院大), 渡辺充広(関東学院大表面研), 本間英夫(関東学院大, 関東学院大表面研)

14:15~14:30

11A-10 PEG誘導体を用いたスルーホールフィリングに関する検討

○中島光志, 中村健太郎, 松原敏明(関東学院大), 杉本将治(関東学院大表面工学研), 本間英夫(関東学院大, 関東学院大表面工学研)

14:30~14:45

11A-11 マイクロ波伝送線路損失に及ぼす金めっきの影響に関する検討

○吉富了平, 小林禰夫, 馬 哲旺(埼玉大)

【B会場】

「材料技術」

9:45~10:00

11B-01 各基板材料への高密着シード層めっきの形成

○金森元気, 田中慎也, 本間英夫(関東学院大), 田代雄彦, 渡辺充広(関東学院大表面研)

10:00~10:15

11B-02 多環芳香族系エポキシ樹脂の高温力学物性

○大西裕一, 大山俊幸, 高橋昭雄(横浜国立大学)

10:15~10:30

11B-03 Cu上の直接無電解Pd/Auめっきプロセスの開発

○工藤喜美子, 田邊靖博, 下地輝明(奥野製薬工業株式会社), 縄舟秀美(甲南大学)

10:30~10:45

11B-04 印刷金属配線の低温形成技術の開発

○吉田 学, 末森浩司, 植村 聖, 星野 聰, 高田徳幸, 小笹健仁, 鎌田俊英((独)産業技術総合研究所)

10:45~11:00 休憩

11:00~11:15

11B-05 印刷デバイス用ナノコンボジット保護膜の低温作製技術の開発

○植村 聖, 末森浩司, 吉田 学, 星野 聰, 高田徳幸, 小笹健仁, 茨木伸樹, 鎌田俊英(産総研)

11:15~11:30

11B-06 ダイレクトメタライゼーション法を利用したポリイミド基板上への銅ダマシ回路形成

○榎本 靖(新日鐵化学), 松村康史(新日鐵化学, 甲南大学), 赤松謙祐, 縄舟秀美(甲南大学)

11:30~11:45

11B-07 金属薄膜を介した低温ウエハ接合

○谷山慎悟, 王 英輝, 須賀唯知(東京大学)

11:45~12:00

11B-08 光塩基発生剤, マイケル付加型架橋剤を用いたアルカリ現象, ネガ型感光性ポリベンゾオキサゾールの開発

○溝口勝久, 上田 充(東工大理工院)

12:00~13:00 休憩

13:00~13:30 ☆招待講演

11B-09 先端機器における実装技術からみる材料の課題

○加藤凡典((有)エー・アイ・ティ)

13:30~13:45

11B-10 めっき銅薄膜強度物性のナノスケール微細組織依存性に関する研究

○村田直一, 玉川欣治, 鈴木 研, 三浦英生(東北大学)

13:45~14:00

11B-11 常温焼結Ag粒子ペーストを用いた低温接合の検討

○和久田大介, 金 檉銖, 菅沼克昭(大阪大学大学院工学研究科)

14:00~14:15

11B-12 黒鉛フィラー垂直配向熱伝導シート

○山本 礼, 吉川 徹, 吉田優香, 矢嶋倫明, 関 智憲, 鈴木雅彦(日立化成工業)

【C会場】

「電子部品・実装技術」

9:45~10:15 ☆招待講演

11C-01 自動車用電子部品の実装技術

○新帯 亮(株式会社デンソー)

10:15~10:30

11C-02 陽極接合できる多層貫通配線LTCC基板による気密封止

○毛利 護(ニッコー株式会社), 富士秀幸, 田中秀治, 江刺正喜(東北大学)

10:30~10:45

11C-03 電気めっきによるマイクロカンチレバーのための機能性材料の創製

- 貝塚 聡, 和田浩史, 和久田陽平, 本間英夫 (関東学院大), 田代雄彦, 渡辺充広 (関東学院大 表面研)

10:45~11:00 休憩

11:00~11:15

11C-04 水素ラジカルを用いた酸化膜除去によるフリップチップ接続状態の改善

- 中島 毅, 和泉 亮 (九州工業大学大学院), 宮本幸司, 佐藤充弘 (長瀬産業), 野北寛太 (北九州産業学術推進機構)

11:15~11:30

11C-05 貼り合わせ工法を用いた新規実装技術における接続ピッチ微細化検討

- 齋藤浩一, 中里真弓, 柳瀬康行, 藤井隆弘, 小林 初, 山本哲也, 岡山芳央, 白井良輔, 井上恭典 (三洋電機)

11:30~11:45

11C-06 半導体デバイス製造プロセス起因の残留応力のマルチスケール計測に関する研究

- 佐々木拓也 (東北大学工学研究科ナノメカニクス専攻), 三浦英生 (東北大学工学研究科)

11:45~12:00

11C-07 三次元チップ積層デバイス用インターチップフィル

- 堀部晃啓, 山田文明 (日本アイ・ピー・エム)

12:00~13:00 休憩

13:00~13:15

11C-08 鉛フリーはんだの高加速試験

- 森田 将, 林 信幸, 中西 輝, 米田泰博 (㈱富士通研究所)

13:15~13:30

11C-09 樹脂入り低融点はんだを用いた部品実装技術

- 佐川智春, 久米 篤, 尾野 靖, 今井隆之 (株式会社フジクラ)

13:30~13:45

11C-10 フラックスレス接続用低融点Sn系薄膜はんだの開発

- 坂本英次, 秦 昌平 (日立製作所), 青木 久, 小泉俊晃, 竹盛英昭, 廣瀬一弘 (日立協和)

13:45~14:00

11C-11 UV改質処理を用いた樹脂上への選択的析出及び異方性成長

- 条谷辰幸, 中丸弥一郎, 井上浩徳 (関東学院大), 田代雄彦 (関東学院大 表面研), 本間英夫 (関東学院大, 関東学院大 表面研)

14:00~14:15

11C-12 低抵抗導電性接着剤とその実装信頼性

- 百川裕希, 石塚直美, 西山知宏, 村上朝夫 (日本電気), 長柄陽子, 水村宣司, 五十嵐仙一 (ナミックス)

14:15~14:30

11C-13 携帯機器用非接触電力伝送コイルの形状と二次側電圧制御方法の検討

- 助川直史, 青木広宙, 越地耕二 (東京理科大学)

14:30~14:45

11C-14 講演中止

【D会場】

「検査技術」

13:00~13:30 ☆招待講演

11D-01 QFP ICのリード浮きの電氣的検出用回路

- 橋爪正樹, 一宮正博, 四柳浩之 (徳島大学), 小野安季良, 高木正夫 (詫間電波工業高等専門学校)

13:30~13:45

11D-02 検査回路の電源電流測定によるICの電源リード浮き検

査能力評価

- 小野安季良, 高木正夫 (詫間電波高専), 一宮正博, 四柳浩之, 橋爪正樹 (徳島大学)

13:45~14:00

11D-03 マルチプローブを用いた微細プリント配線検査システムに関する研究

- 野口祐智, 斎藤之男, 角田興俊 (東京電機大), 田島孝光 (本田技術研究所)

14:00~14:15

11D-04 TDR法を用いたフリップチップのAuバンパ接続の非破壊解析

- 新谷宣明, 進 健範, 韓 榮建, 崔 雲, 友景 肇 (福岡大学)

14:15~14:30

11D-05 X線CTを用いたBGAはんだ接合部の異物検査手法

- 野口健二, 浅井律雄, 村越貴行 (名古屋電機工業株式会社), 寺本篤司 (藤田保健衛生大学)

14:30~14:45

11D-06 複視線角情報を用いたはんだ接合部のニューラルネットワーク視覚検査

- 松嶋道也, 河合直浩, 藤江裕之, 安田清和, 藤本公三 (大阪大学)

3月12日(木)

【A会場】

「光回路実装技術」

9:45~10:15 ☆招待講演

12A-01 JIEP光インターコネクションロードマップWG報告

- 蔵田和彦 (NEC)

10:15~10:30

12A-02 導波型共振器集積グレーティングカップラによる出力結合特性

- 喜多由起, 清水克也, 粟辻安浩, 裏 升吾 (京工繊大), 金高健二 (産総研)

10:30~10:45

12A-03 液浸露光作製埋め込み傾斜微小ミラーによる導波光出力結合

- 村西智行, 清水克也, 井上純一, 西尾謙三, 粟辻安浩, 裏 升吾 (京都工繊大), 金高健二 (産総研)

10:45~11:00 休憩

11:00~11:15

12A-04 自己形成ロッドをもつ光モジュールと光配線板との接続構造の検討

- 小川知訓, 神田昌宏, 三上 修 (東海大学大学院), 児島直之 (古河電気工業株式会社)

11:15~11:30

12A-05 ダイシングを用いた多チャンネルポリマー光導波路フィルム作製

- 木下智嗣, 平野 翔, 池下敏広, 石田宏司 (千歳科学技術大学物質光科学科)

11:30~11:45

12A-06 エッチングレスプロセスによる大面積フレキシブル光配線板作製プロセスの検討

- 加藤尚斗, 小林社一, 石田宏司 (千歳科学技術大学), 須田俊央 (フォトリソサイエンステクノロジー株式会社)

11:45~12:00

12A-07 波長選択スイッチ(WSS)用MEMSミラーアレイのモジュール化技術

- 碓氷光男, 内山真吾, 橋本 悦, 葉玉恒一, 石井雄三, 松浦徹, 阪田知巳, 下川房男 (日本電信電話株式会社)

12:00~14:45 休憩

「システムインテグレーション実装技術」

14:45~15:15 ☆招待講演

12A-08 次世代半導体ロードマップを実現する実装技術

- 西尾俊彦, 森 裕幸 (日本アイ・ピー・エム株式会社, マイクロエレクトロニクス事業)

15:15~15:30

12A-09 貫通電極形成における高速Viaめっき技術

- 門田裕行, 菅野龍一 (日立協和エンジニアリング株式会社), 大貫 仁, 伊藤雅彦 (茨城大学)

15:30~15:45

12A-10 無電解めっき法によるCu微細配線上へのフリップチップ接続用微細Auバンプの作製

- 野村建太郎, 青柳昌宏 (東京理科大学, 産業技術総合研究所), 越地耕二 (東京理科大学), 横島時彦, 山地泰弘, 菊地克弥, 仲川 博 (産業技術総合研究所), 岩井良太, 徳久智明, 加藤勝 (関東化学)

15:45~16:00

12A-11 薄型フリップチップ実装パッケージにおける反り低減技術の開発

- 金高善史, 渡邊真司, 藤村雄己, 山崎隆雄, 村上朝夫 (日本電気(株))

16:00~16:15 休憩

16:15~16:30

12A-12 自己組織化実装によるフリップチップマイクロ接続のための樹脂中フィラーの動力学

- 安田清和, 藤本公三, 松嶋道也, 大田皓之 (大阪大)

16:30~16:45

12A-13 ケミカル・フリップチップボンディングを用いたフェースダウン接続におけるプロセス条件の検討

- 横島時彦, 山地泰弘, 井川 登, 菊地克弥, 仲川 博, 青柳昌宏 (産総研)

【B会場】

「電磁特性技術 (1)」

9:45~10:00

12B-01 高速PCBの電源プレーンの検討

- 上田千寿 (エーイーティ), 大塚寛治 (明星大学)

10:00~10:15

12B-02 大容量3端子コンデンサによる電源電圧変動抑制の検討

- 上野治彦, 櫻井雄吉 (村田製作所)

10:15~10:30

12B-03 両端のみでピア接続を行うガードトレースによるコモンモード放射低減法

- 渡辺哲史 (岡山県工技), 松嶋 徹, 豊田啓孝, 古賀隆治 (岡山大), 和田修己 (京大)

10:30~10:45

12B-04 抵抗付キャパシタによる平面基板からの放射ノイズ低減

- 箱田剛史, 高橋丈博, 作左部剛視, 澁谷 昇 (拓殖大学大学院)

10:45~11:00 休憩

「回路・実装設計技術」

11:00~11:15

12B-05 超高多層プリント配線板の信号収容性に関する一考察

- 上谷 純, 八木貴弘, 廣川正孝, 高山勝之, 白倉幸隆, 芳賀知 (沖プリンテッドサーキット株式会社)

11:15~11:30

12B-06 プリント配線板電源層からの放射雑音低減方法の検討

- 佐々木伸一 (佐賀大学理工学部), 岡部知玄 (佐賀大学大学院)

11:30~11:45

12B-07 BGA基板とプリント配線板間の電磁界の共振の解析

- 菊地秀雄 (トッパンNECサーキットソリューションズ)

11:45~12:00

12B-08 電磁界シミュレーターによる10Gbps高速伝送光トランシーバのEMC対策検討

- 大森寛康 (住友電気工業株式会社)

12:00~13:00 休憩

13:00~13:30 ☆招待講演

12B-09 ギガビット伝送のさらなる高速化に向けて

- 碓井有三 (元株式会社マクニカ)

13:30~13:45

12B-10 シリコン配線基板を用いたマルチチップパッケージの信号伝送特性

- 加藤登志美, 伊藤健志, 川口奈津子, 松毛和久 (㈱東芝)

13:45~14:00

12B-11 超10Gbit/s光トランシーバ用基板の低損失化に関する検討

- 二戸 晃, 大江英輝, 大森弘貴, 松元健悟 (住友電気工業株式会社 伝送デバイス研究所)

14:00~14:15

12B-12 USBメモリケース内蔵型水平面内無指向性UWBアンテナの検討

- 中元克磨, 青木広宙, 越地耕二 (東京理科大学)

14:15~14:30

12B-13 生体用無線センサ端末のための小型アンテナの放射効率増加に関する検討

- 竹田皓平, 増田 誉, 須賀唯知 (東京大学), 伊藤寿浩 (産業技術総合研究所)

14:30~14:45 休憩

「電磁特性技術 (2)」

14:45~15:00

12B-14 OFDM変調を利用した人体通信の検討

- 越地福朗, 竹中秀同, 佐々木 健 (東京大学大学院)

15:00~15:15

12B-15 ESDガンの接触放電での等価回路の検討

- 秋山雪治 (㈱ルネサステクノロジ), 石田武志, 戸澤幸大 (㈱ノイズ研究所)

15:15~15:30

12B-16 TLP同期印加系によるイミュニティ解析

- 塚越常雄 (NECシステム実装研), 渡辺 毅 (NECエレクトロニクス), 中家利幸, 松井信近 (阪和電子工業)

15:30~15:45

12B-17 マルチモードTM0m0空洞共振器を用いた角柱状試料の複素誘電率測定

- 中井 宏, 小林禮夫, 馬 哲旺 (埼玉大)

15:45~16:00

12B-18 左手系右手系複合結合線路の結合特性の検討

- 藤森和哉, 越地耕二, 青木広宙 (東京理科大学大学院)

【C会場】

「信頼性解析技術」

10:00~10:15

12C-01 デジタル画像相関法による車載用パワーモジュールの熱変形評価

- 池田健一, 三宅修吾, 三宅 綾, 荒木俊二, 鈴木康平, 巖 希哲 (コベルコ科研)

10:15~10:30

12C-02 フリップチップ実装構造における薄型Siチップの局所変形分布

- 佐藤祐規, 三浦英生 (東北大)
10:30~10:45
12C-03 電子デバイス用樹脂薄膜の静引張特性
- 岡 昌樹, 張 聖徳, 坂根政男 (立命館大学), 小林 馨, 長澤忠 (京セラ SLC テクノロジー株式会社)
10:45~11:00 休憩
11:00~11:30 ☆招待講演
12C-04 SnCu めっきリードの室温におけるウィスカ発生・抑制機構
- 加藤隆彦 (㈱日立製作所 材料研究所), 赤星晴夫 (㈱日立製作所 日立研究所), 寺崎 健, 岩崎富生 (㈱日立製作所 機械研究所), 中村真人 (㈱日立製作所 生産技術研究所), 橋本知明 (㈱ルネサステクノロジ), 西村朝雄 (㈱実装パートナーズ)
11:30~11:45
12C-05 鉛フリー半導体パッケージのはんだ付け実装におけるウィスカ評価
- 小林晶子, 戸井恵子 (エスベック株式会社 技術開発本部), 梶原隆志, 竹内 誠, 高橋邦明 (エスベックテストセンター株式会社)
11:45~12:00
12C-06 HAST における槽内の酸化雰囲気は PWB に与える影響
- 中村和裕 (新光電気工業株式会社 開発統括部 プロセス開発部)
12:00~13:00 休憩
13:00~13:15
12C-07 高温用鉛フリー接合材料の衝撃特性評価
- 姜 玟, 金 槿珠, 金 道燮, 金 聲俊, 菅沼克昭 (大阪大学)
13:15~13:30
12C-08 高温 IC のための金アルミニウム合金接続の信頼性
- 山口俊樹, 谷口文彦, 庄野 健 (FML)
13:30~13:45
12C-09 鉛フリー微細バンパ接続部の信頼性に及ぼす金属間化合物の影響
- Jeong Seongcheol, 佐藤祐規, 三浦英生 (東北大学)
13:45~14:00
12C-10 LED 光源の光度劣化評価
- 石田 進, 秦 昌平, 水島明子 (日立製作所 生産技術研究所)
14:00~14:15
12C-11 パワーデバイス疲労寿命評価
- 篠原主勲 ((財) 神奈川科学技術アカデミー), 于 強, 安澤貴志, 石井秀明 (横国大)
14:15~14:30
12C-12 導電性高分子コンデンサ「POSCAP」の ESR 寿命推定
- 石田秀樹, 板東正智 (三洋電機株式会社)
14:30~14:45 休憩
14:45~15:00
12C-13 SiC パワー素子の 330°C 長時間接合信頼性
- 郎 豊群, 林 祐輔, 大橋弘通, 山口 浩 (産総研), 谷本 智 (日産自動車)
15:00~15:15
12C-14 Sn-Ag-Cu 系はんだ合金の疲労延性指数におよぼす晶出金属間化合物形態の影響
- 小林 誠 (芝浦工業大学大学院), 荻谷義治 (芝浦工業大学)
15:15~15:30
12C-15 鉛フリー実装におけるガラスセラミック BGA パッケージの寿命予測手法検討
- 中村直章 (富士通アドバンステクノロジー)
15:30~15:45
12C-16 鉛フリーはんだ疲労寿命のひずみ速度依存性
- 李 ハオ, 海老原理徳 (東京学芸大)
15:45~16:00
12C-17 フリップチップパッケージの信頼性解析におけるアンダーフィル材料の粘弾性効果
- 神田喜彦, 座間邦宏 (芝浦工大大学院), 荻谷義治 (芝浦工大), 三上貴央, 小林卓哉 (メカニカルデザイン), 佐藤敏行, 榎本利章, 平田康一 (ナミックス)
16:00~16:15 休憩
16:15~16:30
12C-18 熱履歴によるはんだ接合部の振動負荷に対する寿命劣化
- 松嶋道也, 江草 稔, 獅子原祐樹, 安田清和, 藤本公三 (大阪大学)
16:30~16:45
12C-19 複合負荷下におけるはんだ接合部の疲労寿命評価
- 大森隆広, 廣畑賢治, 向井 稔, 高橋浩之 (株式会社 東芝 研究開発センター), 小川英紀 (株式会社 東芝 PC& ネットワーク社)
16:45~17:00
12C-20 コネクタモジュールの振動による抜け挙動解析
- 館野 正 (富士通アドバンステクノロジー株式会社)
- 3月13日 (金)**
【A会場】
「マイクロメカトロニクス実装技術」
- 10:15~10:45 ☆招待講演
13A-01 集積化 CMOS-MEMS 技術とその応用
- 町田克之 (NTT アドバンステクノロジー), 森村浩季, 武藤伸一郎, 佐藤康博 (NTT マイクロシステムインテグレーション研究所)
10:45~11:00 休憩
11:00~11:15
13A-02 True 3次元貫通配線
- 脇岡寛之, 額賀 理, 山本 敏, 末益龍夫, 橋本廣和 (株式会社 フジクラ)
11:15~11:30
13A-03 FeCoNi 合金の微小構造物の作製
- 山田雅士, 岡本尚樹, 齋藤丈靖, 近藤和夫 (大阪府立大学大学院)
11:30~11:45
13A-04 MEMS 構造に対応した感光性樹脂上へのめっきの応用
- 馬場邦人, 中丸弥一郎, 本間英夫 (関東学院大), 三隅浩一 (東京応化工業株式会社)
11:45~12:00
13A-05 ナノトランスファー法による高配合性 PZT キャパシタの 3次元内蔵基板への転写実装技術
- 牧野 翔, 須賀唯知 (東大) 一木正聡, 前田龍太郎 (産総研)
12:00~14:00 休憩
14:00~14:15
13A-06 金表面活性化接合と三次元構造光マイクロセンサへの応用
- 日暮栄治, 茅野大祐, 須賀唯知 (東京大学), 澤田廉士 (九州大学)
14:15~14:30
13A-07 表面改質を適用した Cu ならびに SiO₂ の低温大気圧接合
- 重藤暁津 (物材機構), 須賀唯知 (東大)
14:30~14:45
13A-08 Au マイクロバンパを用いた表面活性化接合法における大気圧プラズマ活性化法の検討
- 多喜川 良, 日暮栄治, 須賀唯知 (東京大学), 澤田廉士 (九州

大学)

14:45~15:00

13A-09 アルミニウムと垂直配向多層カーボンナノチューブの表面活性化接合

○藤野真久, 須賀唯知 (東大), 水越正孝, 岩井大介 (富士通研究所)

15:00~15:15

13A-10 微細はんだ粒子を充填したシリコンモールドと水素ラジカルフローを用いた微小はんだボール形成

○茅野大祐, 日暮栄治, 須賀唯知 (東京大)

15:15~15:30

13A-11 直列接続圧電薄膜アレイを用いたデジタル出力加速度センサー

○岡田浩尚, 小林 健, 伊藤寿浩 (産総研), 増田 誉, 須賀唯知 (東大)

【B会場】

「環境調和型実装技術」

14:00~14:30 ☆招待講演

13B-01 有機半導体デバイスの将来展望と実装技術

○工藤一浩 (千葉大)

14:30~15:00 ☆招待講演

13B-02 印刷によるCNT薄膜トランジスタの作製

○沼田秀昭, 二瓶史行 (NECナノエレクトロニクス研究所)

15:00~15:15

13B-03 ハロゲンフリーエポキシ樹脂を用いたレジスト材料の開発

内田 博, ○藤田俊雄 (昭和電工株式会社)

15:15~15:30

13B-04 リフロー耐熱のある高信頼性NCF接合

○川手恒一郎, 佐藤義明 (住友スリーエム)

15:30~15:45 休憩

15:45~16:00

13B-05 はんだ代替導電性接着剤の接続信頼性

○本多俊之, 菅 武, 甲斐朋齊, 四ッ柳雄太, 成瀬章紀 (藤倉化成株式会社)

16:00~16:15

13B-06 スケルトン回路構造 (SCS)

○林 秀臣 (東京大学)

16:15~16:30

13B-07 UV改質処理を用いたポリイミド上へのメタライジング

○飯森陽介, 西村宜幸 (関東学院大学), 渡辺充広 (関東学院大学表面工学研究所), 本間英夫 (関東学院大学, 関東学院大学表面工学研究所)

16:30~16:45

13B-08 IT機器用LSIパッケージに含有される金属元素分析

○中澤克仁, 端谷隆文 ((株)富士通研究所)

【C会場】

「部品内蔵基板技術」

10:45~11:15 ☆招待講演

13C-01 部品内蔵基板の設計・評価技術

○友景 肇 (福岡大)

11:15~11:30

13C-02 受動部品内蔵基板の接続信頼性についての報告

○藤巻 升, 尾形繁行, 高見和裕 (沖プリントドサーキット(株)実装技術部), 飯長 裕, 池田幸一, 滝田英司 (沖プリントドサーキット(株)機能モジュール開発1部)

11:30~11:45

13C-03 薄型WLP-IC内蔵ポリイミド多層配線板

○佐野宣紀, 岡本誠裕, 奥出 聡, 鈴木孝直, 中尾 知 (㈱フジクラ)

11:45~12:00

13C-04 一括積層基板における部品内蔵プレス時の樹脂流動制御

○神谷博輝, 竹内 聡, 久保田克典, 清水元規, 三宅敏広, 青山雅之, 近藤宏司 (株式会社デンソー)

12:00~14:00 休憩

「配線板製造技術」

14:00~14:15

13C-05 無電解めっき用Cu混合触媒を用いた絶縁樹脂上へのメタライジング

○井上浩徳, 馬場邦人 (関東学院大), 渡辺充広 (関東学院大 表面研), 本間英夫 (関東学院大, 関東学院大 表面研)

14:15~14:30

13C-06 高アスペクトスルーホールへの無電解銅めっき技術

○兼元 大 (日立材料研), 杉政昌俊 (日立基礎研), 赤星晴夫 (日立日立研), 宮崎智行, 飯田 正 (日立CTM)

14:30~14:45

13C-07 PEG誘導体を用いた電気銅めっきのビア・スルーホールへの適応

○小林正樹, 中島光志, 松原敏明 (関東学院大), 杉本将治 (関東学院大表面研), 本間英夫 (関東学院大, 関東学院大 表面研)

14:45~15:00

13C-08 無電解パラジウムめっき上の無電解金めっきプロセスの検討

○西中山 宏, 藤森友之, 齊藤浩一, 倉科 匡 (大和電機工業株式会社), 縄舟秀美 (甲南大学)

15:00~15:15

13C-09 CO₂ レーザ銅ダイレクト加工の技術動向

○北 泰彦, 久世 修 (日立ビアメカニクス株式会社 設計本部 加工技術センター レーザプロセスG), 道上典男 (日立ビアメカニクス株式会社 設計本部 加工技術センター), 荒井邦夫 (日立ビアメカニクス株式会社 設計本部)

15:15~15:30

13C-10 Cuダイレクトビア加工用黒化処理皮膜の解析

○川村利則 (株式会社日立製作所材料研究所), 赤星晴夫 (株式会社日立製作所日立研究所), 荒井邦夫, 久世 修 (日立ビアメカニクス株式会社)

15:30~15:45

13C-11 DI露光用薄膜テンティングドライフィルム

○西本秀昭, 小谷雄三, 五十嵐 勉, 中村 淳 (旭化成エレクト)

ポスターセッションショートプレゼンテーション

3月13日 (金)

【J会場】

10:00~10:05

13J-01 ArFエキシマレーザーによるシリコンゴム表面への発光層形成

○大越昌幸, 伊代野美奈子, 井上成美 (防衛大学校), 山下嗣人 (関東学院大学)

10:05~10:10

13J-02 Nbナノ粒子を用いた合金薄膜の作成

○配島雄樹, 松村綾香 (関東学院大 大学院工学研究科), 杉山武晴 (関東学院大ハイテクリサーチセンター), 小岩一郎 (関東学院大大学院工学研究科, 関東学院大ハイテクリサーチセンター, 関東学院大物質生命科学科)

10:10~10:15

- 13J-03 フェロセン添加フェノール樹脂を原料とした高導電性電気二重層キャパシタ用電極材料の作製とその特性
- 鈴木スベトラーナ, 目黒竹司, 多々見純一, 脇原 徹, 米屋勝利 (横浜国立大学大学院環境情報学府), 山下嗣人 (関東学院大学)
10:15~10:20
- 13J-04 各種めっき皮膜に於けるトライボロジー試験後の分析
- 小林貴紀, 小岩一郎 (関東学院大物質生命科学科), 配島雄樹 (関東学院大学 大学院工学研究科), 春山義夫 (富山県立大機械システム工学科)
10:20~10:25
- 13J-05 高速伝送分野を視野に入れた基板材料への高密着シード層の形成
- 田中慎也, 金森元気, 本間英夫 (関東学院大学), 田代雄彦, 渡辺充広 (関東学院大学表面工学研究所)
10:25~10:30
- 13J-06 導電性接着剤フィラーへの有機保護層銅系ナノ粒子の適用
- HoLi Ngee, 西川 宏, 竹本 正 (大阪大学接合科学研究所), 柏木行康, 山本真理, 中許昌美 (大阪市立工業研究所)
10:30~10:35
- 13J-07 硫酸銅浴からの高速銅電析における添加剤の電気化学的解析
- 庵地裕史 (関東学院大学工学研究科工業化学専攻), 朝長咲子 (三井金属鉱業株式会社 総合研究所), 山下嗣人 (関東学院大学工学部物質生命科学科)
10:35~10:40
- 13J-08 めっき皮膜へのインヒビター効果と構造学的解析
- 櫻井清仁 (関東学院大学 工学研究科), 浦野吉史 (有限会社ケミカル電子), 山下嗣人 (関東学院大学 工学部), 杉山武晴 (関東学院大学 ハイテクリサーチセンター)
10:40~10:45
- 13J-09 ジンケートフリーのアルミ上への高密着めっき
- 金田龍馬, 貝塚 聡, 本間英夫 (関東学院大学大), 齋藤裕一, 渡辺充広 (関東学院大表面研)
10:45~10:50
- 13J-10 ニッケル電析における浴中添加剤の影響に関するQCMによる解析
- 吉川京佑, 吉原佐知雄 (宇都宮大学大学院工学研究科)
10:50~10:55
- 13J-11 各種PEG誘導体を用いたスルーホールフィリングにおける電気化学的観察とその有効性の評価
- 中村健太郎, 小林正樹, 中島光志, 松原敏明 (関東学院大), 杉本将治 (関東学院大表面研), 本間英夫 (関東学院大, 関東学院大表面研)
10:55~11:00
- 13J-12 銅電析皮膜の構造制御がエッチング特性に及ぼす影響
- 古宇田洋行 (関東学院大学工学研究科工業化学専攻), 後藤敏之, 安谷屋智幸 (三菱ガス化学㈱), 山下嗣人 (関東学院大学工学部物質生命科学科)
11:00~11:05
- 13J-13 走査型電気化学顕微鏡を用いた銅添加剤吸着機構の解析
- 高橋夏樹 (関東学院大学工学研究科工業化学専攻), 本間英夫, 山下嗣人 (関東学院大学工学部物質生命科学科)
11:05~11:10
- 13J-14 硫酸銅浴からの銅電析における添加剤の効果
- 山口 仁 (㈱黄金メッキ), 山下嗣人 (関東学院大学)
11:10~11:15
- 13J-15 耐バリア性に優れた無電解Pd合金皮膜の作製
- 加藤友人, 浅沼雄貴, 中島光志, 井上浩徳, 本間英夫 (関東学院大学), 寺島 肇, 渡邊秀人 (小島化学薬品株式会社)
11:15~11:20
- 13J-16 銅電析における浴中添加剤の影響に関するQCMによる解析
- 高橋拓也, 吉原佐知雄 (宇都宮大学大学院), 松田光由, 土橋誠 (三井金属鉱業株式会社)
11:20~11:25
- 13J-17 BaTiO₃ナノ粒子分散液塗布による薄膜コンデンサの形成と樹脂封孔効果
- 藤吉国孝, 有村雅司, 牧野晃久, 山下洋子 (福岡県工技セ)
11:25~11:30
- 13J-18 高周波・高速伝送向けシクロオレフィンポリマー材への平滑回路形成
- 石田卓也, 渡辺充広, 杉本将治 (関東学院大学表面研), 飯森陽介, 西村直幸 (関東学院大学大学院), 本間英夫 (関東学院大学表面研, 関東学院大学工学部)
11:30~11:35
- 13J-19 無光沢錫めっき後の熱処理がめっき皮膜のウィスカ発生に及ぼす影響
- 尾家義明 (関東学院大学大学院), 山下嗣人 (関東学院大学), 若杉憲治 (株式会社三ツ矢)
11:35~11:40
- 13J-20 FCBGAに対するマルチスケール有限要素法解析
- 大島政男, 谷口文彦, 庄野 健, 郡谷麻紀, 松岡由博 (FML)
11:40~11:45
- 13J-21 エキシマレーザによるピア加工を用いたW-CSPの作製の検討
- 和久田陽平 (野毛電気工業, 関東学院大学), 田村俊夫, 岩田宏治, 山田忠昭, 鈴木 隆 (野毛電気工業), 小岩一郎 (関東学院大学), 安藤 聡, 松野 明 (フェトン)
11:45~11:50
- 13J-22 樹脂粒子による錫皮膜の耐摩耗性の向上
- 林 貴之, 鈴木貴樹, 馬場邦人, 本間英夫 (関東学院大学), 石田卓也 (関東学院大学表面研), 坂 喜文 (株式会社オートネットワーク研究所)
11:50~11:55
- 13J-23 TRISを含む無電解ニッケルめっき溶液の光ファイバブロープへの応用
- 田中宏之, 富岡祐二, 物部秀二 (東洋大)
11:55~12:00
- 13J-24 発泡ポリプロピレンへのめっきによる電磁波シールド形成
- 渡辺充広 (関東学院大学表面研, 関東化成工業株式会社), 齋藤裕一, 本間英夫 (関東学院大学表面研), 尾登真次 (株式会社フォーム化成)
12:00~12:05
- 13J-25 MEMSへの応用を目的とした電気Ni合金めっきによる機能性皮膜の開発
- 和田浩史, 貝塚 聡, 和久田陽平, 本間英夫 (関東学院大), 菅野哲也 (ソノコム), 田代雄彦 (関東学院大表面研)

ものづくりセッション

3月11日(水)
【E会場】
10:00~10:30

- 11E-01 スクリーン印刷によるバンプ形成技術
○村上武彦（ミナミ株式会社）
10:30~11:00
11E-02 MEMSパッケージにおけるシーム溶接技術の検討
○島田照男, 千野 満, 中島増人, 伊藤拓也（ミスズ工業）
11:00~11:30
11E-03 高密度化と混載実装に対応する多機能モジュラマウン
ター
○服部友彦（富士機械製造）
11:30~12:00
11E-04 パワーLED用パッケージにおける今後の技術トレンド
○米村直己（電気化学工業）
12:00~13:00 休憩
13:00~13:30
11E-05 レーザー加熱によるフリップチップ接合技術の開発
○田中栄次, 山岡圭一, 寺田 透（澁谷工業株式会社）
13:30~14:00
11E-06 電子デバイス向け最先端 超音波式フリップチップ接合
○河原幹之（TDK株式会社）
14:00~14:30
11E-07 常温下金属接合材料/Nano Foil
○高橋隆一（㈱イトー）

3月12日（木）

【E会場】

- 10:00~10:30
12E-01 極薄/高剛性高密度プリント配線板用材料の開発
○岸 豊昭（住友ベークライト㈱回路材料研究所）
10:30~11:00
12E-02 高耐熱・低線膨張ポリイミドフィルム「XENOMAX(R)」
○堤 正幸（東洋紡績株式会社）
11:00~11:30
12E-03 次世代低熱膨張率・高弾性率基材
○高根沢 伸, 土川信次（日立化成工業㈱新材料応用開発研究所）
11:30~12:00
12E-04 溶剤可溶型ハイパーブランチャポリイミド樹脂の特性
○宇野誠一, 一ノ瀬栄寿, 伊東聡子, 白井伸佳（DIC株式会社）
12:00~13:30 休憩
12E-05 欠番
13:30~14:00
12E-06 ダイレクトイメージング用ドライフィルムの紹介
○馬場幸雅, 高山陽介, 平林憲明, 中村 淳（旭化成）
14:00~14:30
12E-07 薄型パッケージ用サブストレート材料MEGTRON GX
○元部英次（パナソニック電工株式会社, 電子基材事業部）
14:30~15:00
12E-08 各種フィリング銅めっき技術の紹介
○萩原秀樹（荏原ユーザライト株式会社）
15:00~15:30
12E-09 メタライズ2層FCCL用シード層除去プロセス『SEED-
LON』
○谷本樹一（荏原ユーザライト株式会社）
15:30~16:00
12E-10 高精度エッチング
○秋山政憲（株式会社ケミトロン）
16:00~16:30
12E-11 微細回路対応エッチングシステム
○池田公彦（株式会社ADEKA電子材料開発研究所）
16:30~17:00

12E-12 ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤「トッブルチナシ
リーズ」

○渡邊裕文（奥野製薬工業株式会社）

3月13日（金）

【E会場】

- 10:00~10:30
13E-01 W-CSPにおける三次元実装技術の開発とウエハー加工技
術
○岩田宏治, 和久田陽平, 藤崎純史, 小岩賢太郎, 田村俊夫, 山
田忠昭, 鈴木 隆（野毛電気）
10:30~11:00
13E-02 Gbps クラスインターコネクットの評価
○鈴木敏浩（アンリツマーケティング本部）
11:00~11:30
13E-03 ミリ波ネットワークアナライザの最新技術
○西島英紀（ローデ・シュワルツ）
11:30~12:00
13E-04 銅張りプリント配線基板のマイクロ波・ミリ波評価用測
定装置
○小林禎夫（サムテック（有））, 赤坂清三（㈱川島製作所）, 吉富
了平（埼玉大）
12:00~13:30 休憩
13:30~14:00
13E-05 GHz帯オシロスコープの最新技術動向
○関野敏正（アジレント・テクノロジー・インターナショナル）
14:00~14:30
13E-06 シミュレーションの活用による高速信号の可視化と計測
○辻 嘉樹（レクロイ・ジャパン株式会社）
14:30~15:00
13E-07 3D AOI
古谷睦男（ジャパンコーヨン株式会社）
15:00~15:30
13E-08 自動落下試験装置FITシリーズの開発
○高橋信彦, 来栖高行, 平井省三（株式会社 日立テクノロジー
アンドサービス）
15:30~16:00
13E-09 実装における窒素リフローの有効性について
○中谷瑞葉（東芝ナノアナリス㈱）
16:00~16:30
13E-10 知的簡易型微細デバイス実装装置の実用化
○八木良樹（マイクロニクス株式会社）, 野依正晴（株式会社
KIPS）
16:30~17:00
13E-11 微細配線パターン向けダイレクト露光機
○入江 明（日立ビアメカニクス株式会社）
17:00~17:30
13E-12 プリント基板の小径加工
道上典男（日立ビアメカニクス㈱設計本部）

チュートリアルセッション

3月11日（水）

【G会場】

- 9:45~10:00
実装の重要性とよこはま高度実装技術コンソーシアムの教育体系
横浜国立大学 羽路 伸夫
10:00~10:30
半導体デバイスとその接続法

よこはま高度実装技術コンソーシアム 宮代文夫

10:30~11:00

高速化, 高密度化に対応する高度に進歩した回路基板

よこはま高度実装技術コンソーシアム 高木 清

11:00~11:30

接続と材料: マイクロ接続技術と環境対応接続材料の動向

よこはま高度実装技術コンソーシアム 本多 進

11:30~12:00

実装を支える設計と検査技術

NEC システム実装研究所 井上博文